

導電銀膠

AF-150 HC-1

TDS-150304-054-AC 改

High Conductive Paste

導電銀膠 AF-150 HC-1 是一種使用熱固化聚酯樹脂以及微細的化學銀粉之均勻分散的一液體型的導電銀膠，對於軟板 PET 有良好的附著力。

本產品特徵為有高導電 $\leq 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$ ，適合用在 RFID 的導電回路形成的材料之一。

☆ 優 點

- * 本銀膠在黏度控制下，銀粉可均勻的分散在樹脂結合劑，不會有 Pin Hole 出現，有穩定平衡的導電膜高性能材料。
- * 連續印刷性佳。
- * 固化條件為『130 ~ 150°C X 30 分』，固化膜可形成附著力及導電性佳的導電材料。

☆ 特 性

		AF-150 HC-1	
外 觀		中黏度銀白色膏狀	
黏 度		200 ~ 300 dPa · s at 25°C	Viscotester VT-04F
固 化 條 件		130°C ~ 150°C × 30 分	Box 乾燥機
密 著 性		100 / 100 PET Film 100μ	Cross Cut · Peeling
表 面 硬 度		≥2H	鉛筆硬度測試器
比 抵 抗		10 ⁻² Ω · cm 10 ⁻⁴ Ω · cm 10 ⁻⁵ Ω · cm	固化條件 50°C/30 分 固化條件 100°C/30 分 固化條件 130°C/30 分
撓 曲 性		≤ 30%	180 度/表裡/3 次

* 上述數值為廠司之研究實驗值，而非保証數據

☆ 使用方法及取樣上之注意事項

- 請務必使用原樣品。若需要稀釋的話，請使用專用稀釋劑「Carbitol Acetate」。
- 使用前或添加稀釋劑之後，請均勻攪拌後使用之。
- 塗佈之前請先務必清潔塗佈表面，以免造成密著性及導電性下降。
- 塗佈時，適合使用綱絲版、網版(250~400 Mesh)。乳劑厚度適合用在 5~10 μ m。
- 硬化條件請設定在溫度 135 至 150 °C 烘烤時間 30 分範圍內。
- 欲清洗使用後之網版、治具及容器，請使用丙酮/Acetone 及酯類/Ester 溶劑。
- 產品取樣時，請務必穿著護具於抽氣良好之作業場所下操作之。
- 使用保存期限為 4 個月 (於 25 °C 存放下)。